

## 「IC 產業同盟計畫」專題演講 有助提升整合力與競爭力

2013-4-21 12:52

記者季大仁／新竹報導

面對全球化競爭與經濟危機、IC 產品生命週期越來越短、製程技術門檻越來越高、研發成本與資本支出不斷提升等挑戰，清華大學 22 日將舉行「國科會 IC 產業同盟計畫」暨「清華-台積電卓越製造中心」啟航茶會暨專題演講，探討台灣產業結構轉型，及供應鏈整合力與競爭力提升。

「IC 產業同盟-半導體供應鏈虛擬垂直整合計畫」為清華大學執行國科會產業技術聯盟計畫，並特別整合與台積電、創意電子、采鈺科技等公司的產學合作計畫為實證研究，同時成立「清華-台積電卓越製造中心」。「IC 產業同盟計畫」研究團隊將累積的研究成果和分析技術往半導體供應鏈上下游擴散並整合，以有效地促進半導體供應鏈「虛擬垂直整合」，協助台灣以水平分工為主的產業結構，能與垂直整合的國外廠商競爭。

活動舉辦哈佛大學商學院的 Willy Shih 教授主講「The return of vertical integration, or a question of scale?」，以及台積電 孫元成副總經理暨技術長主講「半導體技術趨勢與機會」等兩場專題演講。總主持人簡禎富特聘教授也將報告計畫目標與研究規劃。清華大學陳力俊校長、台積電蔣尚義營運長、孫元成副總經理暨技術長、創意電子賴俊豪總經理、采鈺科技辛水泉總經理、國科會工程處朱曉萍副處長、果尚志研發長、王茂駿院長等貴賓也主持在工程一館 806 研究中心的揭幕儀式。

簡禎富特聘教授說，「IC 產業同盟計畫」將扮演觸媒和第三方的角色來協助不同公司解決跨供應鏈上下游的問題，包括良率提升、晶圓綜合效益、產能規劃、存貨天數管理、供應鏈效率及 18 吋晶圓生產系統等研究議題，累積「問題點」的突破為基礎，再擴大為供應鏈整合的系統決策機制，建立解決大型複雜問題的完整解決方案，以提升虛擬垂直整合之綜效。

簡禎富教授也提到，清華團隊除了已與台積電、創意電子、采鈺科技、旺宏、聯發科、廣達電腦、台達電、晶元光電、世界先進、茂迪等公司的產學合作計畫外，並與哈佛大學 Willy Shih 教授合作發表台積電、聯發科、創意電子等多篇哈佛管理個案，發揚台灣高科技產業的成功典範和國際影響力。

清華史欽泰講座教授也以 STEP 的意涵，書寫「千里之行始於足下，百尺竿頭更進一步」墨寶，勉勵 NSC STEP 團隊能夠研究半導體產業未來挑戰的重要議題，以協助台灣產業結構轉型、提升台灣半導體產業競爭力。

更多：台灣好新聞：<http://yam.taiwanhot.net>